

股票代码：688519

股票简称：南亚新材

### 南亚新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位名称</b>	易方达基金；国寿安保基金；国泰基金；国投瑞银基金；金鹰基金；西南证券；国金基金；嘉合基金；摩根士丹利基金(中国)；天弘基金；国融基金；汇丰晋信基金；新华基金；富荣基金；九泰基金；蜂巢基金；西部利得基金；太平基金；泓德基金；清禾私募；百川财富；锐方基金；诺德基金；恒越基金；民生加银基金；中庚基金；中海基金；华泰柏瑞基金；东方基金；嘉实基金；中邮创业基金；中信保诚；上海贵源投资；鸿运私募基金；中天汇富基金；上海景林资管；上海玖鹏资管；沃珑港投资；华福证券；长城证券；开源证券；华泰证券；东北证券；首创证券；西部证券；中原证券；华创证券；汇丰前海证券；财通证券；浙商证券；爱建证券；南京证券；中国国际金融；安信证券；长江证券；德邦证券；高盛中国证券；中信证券；中银国际证券；山西证券；中国银河证券；华金证券；招商证券；恒泰证券；中信建投证券、湖南长心私募；上海大朴资管；红杉资本(天津)；庐雍资管；瑞华投资控股；呈瑞；益和源资管；瀚伦私募基金；伯利恒资管；重庆德睿恒丰；海创私募基金；上海嘉世私募；北京衍航资管；张家港高竹私募；尚诚资管；深圳量度资本；创富兆业金融；上海保银私募；珠海唐丰投资；深圳恒德投资；艾汐资管；歌汝私募基金；盈峰资本管理；耕霖(上海)投资；上海标朴投资；仁桥资管；湖南源乘私募；盘京；巨人资本（香港）、上海悦溪私募；瑾谷资管；乾锦豪资管；南土资管；基明资管；洪泰同创投资；海南鸿盛私募；北京磐泽资管；三鑫资管；复通(山东)私募；国信中数投资、财通证券资管；申万宏源资管；光大证券资管、大家保险；上海人寿；阳光资管；方正人寿；中意资管；新华资管、ArtisanPartnersAssetManagement；国泰君安国际；永灵通金融；花旗環球金融、第一上海证券；统一证券；博裕资本、平安银行、汇华理财、华能信托；华宝信托、度势投资；今日头条；华曦资本；盛钧基金；进门财经科技；中泽控股；由榕

	管理；丞毅投资；纳弗斯信息；世嘉控股；君义振华；鼎睿资产、赢舟资产管理有限公司；Inpsur Capital；朱峰投资；久谦咨询；东方证券；国联民生证券；国泰海通证券；山合投资；兴业证券；华源证券；东吴证券；中泰证券；中金公司；平安证券；
时间	2025年04月24日-2025年04月25日
地点	南亚新材公司及线上交流
上市公司接待人员姓名	董事长：包秀银 副总经理：席奎东 董事会秘书：张柳 副总经理：刘涛 财务总监：解汝波
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问 1：公司 2024 年年度及 2025 年第一季度经营业绩变化情况原因？</b></p> <p><b>答：</b>1、2024 年年度业绩变化原因 2024 年年度，公司营业收入为 336,154.10 万元，同比增加 12.70%；归属母公司股东的净利润为 5,032.02 万元，较上年同期增加 17,981.02 万元，实现扭亏为盈；扣除非经常性损益后的净利润为 2,804.24 万元，较上年同期增加 17,860.88 万元；综合毛利率为 8.65%，较上年同期增加 4.49 个百分点。 2024 年度，公司毛利率提升主要系报告期内公司加强内部管理，提升内部业务协同管理能力和运营效率，同时积极调整营销策略，优化产品结构所致。</p> <p>2、2025 年第一季度业绩变化原因 公司 2025 年第一季度销售收入 95,245.08 万元，同比增加 29,576.35 万元。实现净利润 2,112.07 万元，同比增加 1,101.72 万元。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,603.66 万元，同比增加 774.44 万元。主要系第一季度公司积极拓展市场，产品销量提升，同时优化产品结构，毛利率提升影响所致。</p> <p><b>问 2：近几年 AI 算力迅猛发展，当前国际局势复杂多变，我国的 AI 芯片受到西方大国的制裁。在这样的背景下，南亚新材有什么样的材料解决方案来助力我国 AI 服务器的快速发展。</b></p> <p><b>答：</b>针对 AI 服务器的发展，随着 AI 芯片性能的提升，一方面 AI 芯片用到的制程越来越先进，另一方面 AI 芯片的总体尺寸也在增加。国内 AI 芯片的制程受到限制，AI 芯片的尺寸会变得更大。这不可避免的为 PCB 的贴装带来了更大的难度与</p>

挑战。公司技术发展新需求开发的 NY-8888N/NY-6666N 等兼顾 Low CTE 特性的高速材料，除了保证优异的电性能之外，还减小了板材的 CTE，使用 NY-8888N/NY-6666N 板材的 PCB，具有更好的尺寸稳定性，从而大大减小了 AI 大尺寸芯片贴装的难度，也同时提高了 AI 服务器整机的长期可靠性。

**问 3：现阶段中美关税贸易战升级，对于材料国产化与供应链安全问题越来越关注，公司在关键原材料(如树脂、铜箔、玻布)国产化方面进展如何？特别是高速材料所需的高阶原材料是否有被“卡脖子”风险？目前国内产能能满足持续增长的需求么？**

**答：**上游原物料的自主可控对供应链安全至关重要。公司在高速领域发展迅速，期间对上游关键原物料国产供应商积极引入，联合开发，已实现 M8 及以下等级产品原物料国产化替代，具有良好的供应链优势，有利于高速覆铜板市场占比提升。目前，公司 M7/M8 等级原物料国产化产品已实现批量交付。

公司国产高阶原材料供应商与公司合作稳定，保供能力强，且其产品技术随着国产化产业链的发展而升级，我们相信能够满足未来 AI 发展所需。

**问 4： 2025 年公司在载板材料和 HDI 材料方面取得了哪些进展？**

**答：**在载板材料领域，公司已针对存储类产品、RF 芯片(具备 low Dk/Low Df 属性)两大领域布局产品规划，开发的具有低 X、Y 轴热膨胀系数，优秀的电性能，高刚性的性能特点的产品。在 HDI 材料领域，针对适用于智能终端应用的高集成化、高密度互联的电子材料，掌握配方核心技术，已开发出一系列具有优秀的电性能与尺寸稳定性，低热膨胀系数，高耐热，高可靠性的性能特点 HDI 材料，综合性能指标处于国内领先水平。自 2024 年起，公司已开始对国内数家主要终端制造商所需的存储和手机材料进行认证测试。预计到 2025 年，这些努力将初见成效，并有望在未来一年内带来小批量订单。

**问 5：目前整体的产能情况和稼动率情况如何？2025 年产能扩充计划。**

**答：**截至目前，公司上海生产基地设有 N1-N3 工厂，江西生产基地设有 N4 -N6 工厂，其中，N1-N2 工厂因能耗、人耗高，效率低已停产，N3 工厂 80 万张左右/月，N4 工厂 100 万张左右/月，N5 工厂 120 万张左右/月；N6 工厂 2025 年 3 月末新增产能 60 万张/月，已累计释放产能约 90 万张/月。截止目前，公司整体达产产能约 390 万张/月，N6 剩余一条线约 30 万张/月预计下半年落地，到今年年底，公司产能将突破 400 万张/月。当前产能稼动率约 9 成，同比提升明显。

除 N1-N6 工厂外，公司已在江苏南通生产基地投建首个高

端电子基材工厂，建设有序开展中，第一批产能有望在明年年底落地。公司已在泰国购地规划海外生产基地，并将视行业趋势和地缘政治节奏推进，目前已办结 BOI 证书并取得工业地块地契。

**问 6: 公司与国内核心终端客户的关系及在高端高速材料领域的持续性展望如何?**

答: 公司与国内核心终端保持着较长期且深入的合作关系,特别是在高速高阶材料方面,公司协助其实现材料全 C 化取得了显著的成绩,并在国内友商中已具备量产先发优势。

终端客户在高端材料领域对供应链的要求较高,由于可选供应商较少,公司高速产品凭借稳定的性能,快速的交付,优良的服务为双方持续合作奠定了坚实基础。

现阶段,公司对于核心终端算力产品的需求,首要任务是保品质、保交付,已取得较大比重份额,与其他日系和台系友商构成竞争。同时公司正紧跟其步伐,不断迭代研发高速产品,以确保下一代产品的供应地位。

产品在核心终端客户的示范效应及技术的持续迭代,使得公司在未来发展的市场上具有一定先发优势。

**问 7: 如何看待与台系厂商的竞争优势及未来展望?**

答: 公司与台系厂商相比,在产能规模、技术和供应链等方面已经具备竞争力,尤其在高阶高速产品应用领域率先实现了国产化应用突破。伴随着国产化的推进和国内供应链的成熟,后续将进一步提升市场份额,实现营收利润双增长。

**问 8: 高速光模块和高速连接器近几年来发展迅速,南亚新材在高端光模块和高端连接器产品领域有什么样的布局。**

答: 现在高端光模块和高端连接器的市场需求旺盛,400G,800G 光模块和连接器产品出货量都屡创新高。公司 NY-6300S/NY6300SN 等高速材料具有优异的电性能和可加工性,能够很好的适配 400G,800G 的高速光模块和连接器。另外针对现在最高端的 1.6T 光模块及 CPO 光电共封装产品南亚新材的 NY-6666N/NY-8888N 等材料相较于普通材料具有更低热膨胀系数能更好适配高多阶 HDI 技术与 Msap 制程,同时可以有效提高 CPO 产品的良率。

**问 9: 公司如何在当前环境下保持竞争优势?**

答: 公司通过国产化、聚焦大客户战略以及强化高速产品优势来保持竞争力。我们不断提高基本盘的成本竞争力,提升大客户的占比,优化产能利用率;同时,持续推进产品结构转型,扩大战略盘产品的生产规模,保证性能稳定的基础上实现快速交付。此外,公司注重人才管理和培养,确保团队稳定性及应对市场竞争的能力。

**问 10: 公司如何在台湾及海外市场推动高速材料业务的拓展, 与海外大厂合作认证方面有何突破进展?**

答: 公司在台湾市场深耕多年, 成立了海外技术推广和支持团队, 并不断引进行业优秀人才全面布局。台湾市场方面, 我们聚焦于伺服器与高速网通应用。目前已进入多家客户的设计阶段或正在进行导入认证。

而在海外市场方面, 公司的高速材料能够支援包括 PCIe 5.0/6.0、800G / 1.6T Ethernet、AI Server 等高端应用。在 Ultra Low Loss I 等级材料, 已被多家客户纳入既有平台测试。Intel/AMD 两大主流新品的各平台认证我司各等级都有亮眼的表现, 且已开始通过 PCB 客户积极与全球 GPU 和 AI 计算技术为核心的知名科技公司展开产品的认证, 为产品全面推广做好铺垫。

**问 11: 目前是否存在高端产能紧张的情况, 以及产能转换的可能性?**

答: 产能紧张程度与产线配置密切相关。目前 N3-N6 工厂生产线均能支持高速产品生产, 预备产能充足, 且产能切换灵活。

**问 12: 在汽车圈内, 有个共识, 新能源汽车上半场的电动化已经告一段落, 下半场是智能化的争夺战。贵司在汽车智能化领域, 材料有什么新的进展?**

答: 公司在车载智能化的主力产品有: NY3170M、NY-A3HF、NY-A5HF、NY-A6HF。随着新能源汽车在国内的快速发展, 已经从“电动化”迈向“智能化”。AI 技术正在重构汽车的智能化体验, 已从“辅助工具”演进为“核心中枢”。这就意味着, 对材料供应商来说, 技术方案要兼具技术创新和成本优势。公司主推的车载智能化产品, 从 Mid-loss 到 Very low loss, 从 low CTE 到 Very low CTE, 材料能力从高多层到 Anylayer, 性能全方位适应, 做到“商用一代、储备一代、预研一代”。

**问 13: 贵司 AI 服务器材料应用最新进展? 国内智算 GPU 模组 224G 产品我司有无应对材料及开发进度?**

答: 公司 NY6300S 全面进入多客户 PCIe Gen5 服务器量产, PCIe Gen6 完成头部客户测评, 进入产品预研阶段; AI 服务器突破多客户国产 GPU 方案, 材料含盖 M6-M8U 等级, 全栈式适配 UBB,OAM 及 AI 系统主配板。

公司 224G 产品针对目前国内芯片现况我司推出了极致 LOW CTE 二款材料 NY-P5 及 NY9999Q (有卤及无卤), CTE 能满足 1035 单张 3MIL 布 XY 方向满足 13PPM 内, 属于行

	业前列水平,目前在头部的 AI 智算公司作相关材料性能验证。
附件清单 (如有)	
日期	2025 年 04 月 25 日